이 보고서는 시가총액 5,000억 원 미만의 중소형 기업에 대한 투자정보 확충을 위해 발간한 보고서입니다.



작성기관 (축)NICE디앤비 작성 자조성아 선임연구원 ► YouTube 요약 영상 보러가기



- 본 보고서는 투자 의사결정을 위한 참고용으로만 제공되는 것이므로, 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 보고서를 활용한 어떠한 의사결정에 대해서도 본회와 작성기관은 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 본 보고서의 요약영상은 유튜브(IRTV)로도 시청 가능하며, 영상편집 일정에 따라 현재 시점에서 미게재 상태일 수 있습니다.
- 텔레그램에서 "한국IR협의회" 채널을 추가하시면 매주 보고서 발간 소식을 안내 받으실 수 있습니다.
- 본 보고서에 대한 자세한 문의는 작성기관(TEL.02-2122-1300)로 연락하여 주시기 바랍니다.

차세대 첨단표면처리 산업 선도기업

기업정보(2024,11,19, 기준)

 대표자
 김지훈

 설립일자
 1971년 3월

 상장일자
 2003년 1월 7일

 기업규모
 중소기업

 업종분류
 기타 화학제품 제조업

 주요제품
 표면처리약품

시세정보(2024,11,19, 기준)

현재가(원)	272원
액면가(원)	100원
시가총액(억 원)	475억 원
발행주식수	174,460,917주
52주 최고가(원)	469원
52주 최저가(원)	251원
외국인지분율	0.66%
주요주주	
㈜텔콘알에프제약	22.81%

■ 표면처리약품 및 장비 전문기업

케이피엠테크(이하 동사)는 1971년 설립되어 표면처리 관련 약품을 상품 및 제품의 형태로 유통하거나 제조하고 있으며, 도금처리 및 표면처리를 기계적으로 처리하는 작업에 필요한 설비 및 부품을 제조하고 있다. 주로 주문 제조 판매 형식으로 제품을 공급하고 있으며, 해외 수출을 병행하고 있다. 동사는 표면처리장비와 약품을 동시에 제공하여 장비에 적합한 약품으로 불량률을 낮추고, 안정적인 매출 확보의 효과를 얻고 있으며, 고객 맞춤형 솔루션을 제공하여 고객사 품질 향상에 기여하고 있다.

■ 꾸준한 성장이 예상되는 표면처리 산업

동사의 핵심사업인 표면처리약품 및 도금설비가 해당하는 표면처리 산업은 다양화·세분화·첨단화 트렌드에 맞춰 다양한 표면처리 기술이 개발되고 있으며, 비교적 역사가 오래된 시장임에도 불구하고 새로운 고부가가치 기술 수요가 지속적으로 발생함에 따라 꾸준한 시장 성장이 예상된다. MarketsandMarkets(2023)에 따르면, 국내 금속 표면처리 시장규모는 2022년 기준 6조 1,786억 원이며, 이후 연평균 5.3% 증가하여 2027년 7조 9,792억 원에 이를 것으로 전망된다. 국내 금속 표면처리 분야는 첨단산업의 핵심 솔루션으로 주목받고 있으며, 디스플레이, 반도체 등 각종 첨단분야에서의 활용도가 높아짐에 따라 시장 및 기술 선점을 위한 경쟁력 확보방안이 요구되고 있다.

■ 베트남 법인 등 해외시장 확장으로 글로벌 경쟁력 강화

동사는 2017년 베트남 법인을 설립하고 일본, 독일, 대만 등 글로벌 업체들과 경쟁하고 있으며, 국내 시장에서 동사 제품의 가격 및 품질, 기술 면에서의 경쟁력 및 인지도가 상승하고 있고, 이를 바탕으로 국내 시장 점유율을 높여가고 있다.

요약 투자지표 (K-IFRS 연결 기준)

	매 <u>출</u> 액 (억 원)	증감 (%)	영업이익 (억 원)	이익률 (%)	순이익 (억 원)	이익률 (%)	ROE (%)	ROA (%)	부채비율 (%)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	PBR (배)
2021	359.2	55.2	-80.5	-22.4	-419.2	-116.7	-37.2	-27.9	40.2	-293	657	-	1.7
2022	412.9	15.0	-4.5	-1.1	-120.5	-29.2	-11.9	-9.3	32.2	-74	613	_	0.6
2023	455.0	10.2	-144.6	-31,8	-89.4	-19.7	4.9	-5.9	39.1	30	618	13.3	0.6

기업경쟁력 - 기업경쟁력					
표면처리약품 및 설비 제조	 ■ 오랜 업력과 축적된 기술력으로 고객 주문 맞춤형 표면처리약품 및 장비 제공 ■ 고객사 요구에 맞는 표면처리장비를 제공하며, 납품한 기계에 사용되는 약품을 함께 제공하여 안정적인 매출 확보 ■ 표면처리장비 및 약품 납품 일원화로 장비와 약품이 조화로워 문제 발생이 적고, 문제 발생 시에도 즉시 대응 가능 				
연구개발 역량	 ■ 기술연구소를 통해 기술인력 확보 및 양성, 신제품 개발과 성능 개선 연구활동으로 지속적인 신제품 및 기능 향상 제품 출시 ■ 국내 특허권 7건, 상표권 4건, 디자인권 1건 등 지식재산권 확보를 통한 기술장벽구축 				

핸신 기숙 및 전용제품

	핵심 기술 등	핵심 기술 및 적용제품									
표면처리약품	- PCB 약품, 기능성 도금 약품, 일반 장식 약품 등 100여 종의 표면처리 약품 국산화 - PTC-CAT, PURICLE C-4, RS-370 등 - 고객사 요청에 따라 맞춤형 약품을 제공하고 있으며, 표면의 활성화를 통해 도금의 접착력을 높이고, 최종 제품의 내구성을 향상시키는 데 기여										
전자동 도금설비	 PCB 도금장치, ABS 도금장치 설비용 약품 판매로 안정적 매출 확보 주력제품은 PCB 산업에 적용되는 수직 연속 이송 표면처리 설비(VCP)로 Wire Clamp Transfer(WCT) 시스템을 적용하여 제품 품질을 향상시키고 불량률을 감소 										

	년도	시장 규모	연평균 성장률				
국내 금속 표면처리 시장 규모	2022년	6조 1,786억 원	▲5.3%				
	2027년(E)	7조 9,792억 원					
	년도	시장 규모	연평균 성장률				
세계 금속 표면처리 시장 규모	2022년	993억 달러	. F 40/				
	2027년(E)	1,199억 달러	▲5.1%				
시장환경	■ 정부는 '뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률'에 의거 '표면처리' 산업을 6대 뿌리산업으로 선정하여 금속 표면처리 산업에 대해 지속적으로 지원하고 있음. ■ 금속·기계 분야의 최종제품에만 적용되었으나, 다양한 산업현장에서 품질경쟁력을 확보하기 위한 필수 요소로 자리매김함에 따라 산업 다양화·세분화·첨단화트렌드에 맞춰 매우 다양한 표면처리 기술들이 개발되었음. ■ 비교적 역사가 오래된 시장임에도 불구하고 새로운 고부가가치 기술 수요가지속적으로 발생함에 따라 꾸준한 시장 성장이 예상됨.						

I. 기업 현황

축적된 노하우를 바탕으로 표면처리 약품과 설비에서 최적의 솔루션 제공

동사의 주요 사업은 표면처리 약품과 표면처리 기계 부문으로 구성되며, 주 수요층은 PCB 및 전자부품 제조업체로 동사는 오랜 업력과 기술력을 기반으로 탄탄한 수요층을 확보하고 있다.

■ 기업 개요

동사는 1971년 3월 한국도금재료공사로 설립되어 도금에 필요한 약품 및 표면처리 기기의 국산화에 앞장섰다. 창립 초기에는 도금, 표면처리 약품을 주로 생산하였으나 전자동 도금설비 제작으로 사업영역을 확장하였다. 2003년 1월 코스닥에 상장하였으며, PCB 및 전자부품 제조업체를 대상으로 각종 도금처리와 표면처리 약품, 도금 설비, 부품 등을 제공한다. 축적된 노하우와 기술인력 보강, 인적 인프라 강화 및 해외 법인 설립 등의 시너지를 통해 원가절감 등 표면처리약품 사업에서의 경쟁력을 강화하고 있다.

[표 1] 동사의 주요 연혁

일자	내용				
1971.03	한국도금재료공업사 설립				
1977.11	일본 상촌공업주식회사와 기술제휴(도금약품 국산화)				
1979.11	일본 상촌공업주식회사와 기술제휴(자동도금기계 국산화)				
1980.04	일본 ㈜삼진제작소와 기술제휴(표면처리용 여과기 국산화)				
2000.04	㈜케이피엠테크로 상호변경				
2003.01	코스닥 상장				
2006.02	NAP(Nano Attached Power)공법에 의해 분말형태(건식)의 원재료 표면에 은(銀)나노 입자가 형성된 파우더의 제품화 성공 신규 사업 진출				
2006.06	금속박막코팅 표면처리(건식) 신규 사업 진출				
2010.03	프랑스 알츠머社와 기술협약 체결				
2015.09	심천시 고려표면처리 유한공사(중국 심천) 설립				
2016.08	대표이사 변경(채병현 대표이사 사임, 이청균 대표이사 취임)				
2017.11	베트남 법인(KPM TECH VINA CO., LTD.) 설립				
2018.03	대표이사 변경(이청균 대표이사 사임, 김지훈 대표이사 취임				

자료: 동사 분기보고서(2024.09.)

2024년 9월 말 기준, 동사의 최대주주는 ㈜텔콘알에프제약으로 동사 지분의 22.81%를 보유하고 있다. 동사의 계열회사로는 지배기업인 ㈜텔콘알에프제약과 연결대상 종속회사로 ㈜리버스파트너스, KPM TECH VINA CO., LTD. 등 6개 사가 있다.

[표 2] 최대주주 및 특수관계인 주식소유 현황

주주명	지분율(%)
㈜텔콘알에프제약	22.81
기타 주주	77.19
합계	100.00

[표 3] 주요 계열사 현황

회사명	주요사업	총자산(단위: 억 원)
㈜텔콘알에프제약	완제의약품 제조	1,404
 ㈜리버스파트너스	경영컨설팅	382.6
KPM TECH VINA CO., LTD.	도금약품 및 설비	77.2
㈜에이엠아이인베스트먼트	경영컨설팅	33.7
㈜코스인베스트먼트	경영컨설팅	286.3
티피-뷰티 제2호 종합	투자조합	4.7

자료: 동사 분기보고서(2024.09.), NICE디앤비 재구성

■ 대표이사 경력

김지훈 대표이사는 재무 및 경영관리 분야의 전문가로 ㈜에버코어인베스트먼트 등에서 대표이사를 역임하였으며, 경영 전반에 대한 폭넓은 경험을 바탕으로 2018년 동사에 취임하여 현재까지 경영을 총괄하고 있다. 또한, 동사의 계열회사인 ㈜리버스파트너스, ㈜에이엠아이인베스트먼트, ㈜코스인베스트먼트, ㈜텔콘알에프제약의 대표이사도 겸임하고 있다.

■ 주요 사업

동사의 주요 사업 분야는 표면처리 관련 약품 사업 부문과 기계 사업 부문으로 구성되어 있다. 표면처리 관련 약품은 PCB 약품, 기능성 도금 약품 및 일반 장식 약품을 제공하며, 100여 종 이상의 약품을 취급하고 있어 다품종소량생산체제를 구축하고 있다. 기계 사업 부문은 PCB 도금장치, ABS 도금장치 등을 제공하고 있다. 주요 사업인 표면처리사업 외에도 제약 및 바이오 사업분야에 대해 관계회사 등을 통하여 직·간접적인 투자 등을 진행하고 있다.

■ 주요 고객사

표면처리 약품은 PCB 약품, 기능성 약품(자동차용, TV용, 반도체용), 장식용 약품(자동차 손잡이, 액세서리, 귀금속), 기타(환원제, 여과기, 세정제, 에칭제) 다양한 분야에 납품하고 있으며, 전자동 도금설비는 PCB 업체를 주요 고객사로 한다. ㈜대신지테크, Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen Co., Ltd. 등 중견 PCB 업체를 고정 거래처로 확보하고 있다.

ESG(Environmental, Social and Governance) 활동 현황





◎ 환경친화적 표면처리 약품 연구



◎ 국가 환경법 준수





◎ 임직원에 평등한 기회를 부여하며,삶의 질 향상에 주력



○ 건강검진, 자기개발비 지원, 식사제 공, 기숙사 운영, 경조금, 기숙사, 구내식당, 헬스시설 지원





- ◎ 경영 투명성 제고를 위한 정관 및 이사회 등의 운영 시스템 구축
- ◎ 이사회의 전문성과 독립성 보장을 위해 관계 법령 및 정관의 규정사항 준수 운영

Ⅱ. 시장 동향

새로운 고부가가치 기술 수요로 꾸준한 시장 성장이 예상되는 표면처리 산업

동사의 핵심사업인 표면처리약품 및 도금설비가 해당하는 표면처리 산업은 다양화·세분화·첨단화 트렌드에 맞춰 다양한 표면처리 기술이 개발되고 있으며, 비교적 역사가 오래된 시장임에도 불구하고 새로운 고부가가치 기술 수요가 지속적으로 발생함에 따라 꾸준한 시장 성장이 예상된다.

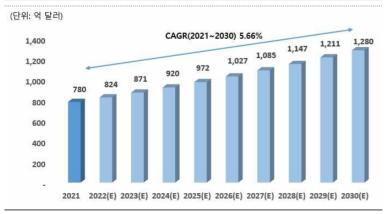
■ PCB 산업

동사의 핵심사업인 표면처리약품 및 도금설비의 주요 수요층이 되는 전방산업은 핵심 전자부품의 필수 산업인 PCB(Printed Circuit Board, 인쇄회로기판) 산업이다. PCB 산업은 전반적으로 기계, 자동차, 항공기, 반도체등 전방산업의 안정적 수요를 기반으로 성장해 왔으며, OEM 방식으로 휴대폰, 컴퓨터, 가전 등 전방산업 업황변화에 매우 민감한 산업이다. 그 중 전기절연성을 가진 유연한 기판 위에 도체를 도금해 회로를 형성한 전자부품인 FPCB(Flexible PCB, 연성회로기판) 산업은 전자제품의 경량화 및 소형화에 따라 적용 제품군이 확대되며 시장규모가 증가하고 있고, 전통적인 RPCB(Rigid PCB, 경성회로기판) 산업을 유지해나감과 동시에 최신의 IT추세를 반영하여 고수익 창출 가능성을 높이게 되었다. 특히 관통홀(via hole)로 층 사이의 접속을 이루며 한층 한층을 도금, 프린트 등으로 가공하여 차례로 적층한 다층 인쇄회로기판인 빌드업과 부품 실장이 필요한 부분은 Rigid기판, 굴곡이 필요한 부분은 Flexible 기판을 동시에 사용하고자 두 가지 기판을 복합 일체화한 RFPCB(Rigid-Flexible PCB, 경연성 회로기판)등 고도의 기술력을 필요로 하는 제품의 비중 증가는 기술력의 수준에 따라 수익성을 차별화할 수 있다는 것이 특징이다.

PCB산업에서의 표면처리약품 및 도금설비 사업은 고객(Set Maker)이 제품을 설계하고 이를 수주하여 생산하는 전형적인 고객 주문형 산업이기에 고품질과 납기 준수가 중요한 고객 지향적 산업이다. 인쇄회로기판의 제조 공정은 그 특성상 반도체나 LCD산업과 마찬가지로 전 공정이 설비에 의존하는 완전 주문형 생산 장치 산업으로, 최근 다양한 전기적 특성, 크기, 부피, 두께 등 PCB의 제조 기술이 발전하며 생산공정이 더욱 복잡해지고 고도의 기술력이 요구됨에 따라 설비의 중요성은 지속해서 커지고 있다.

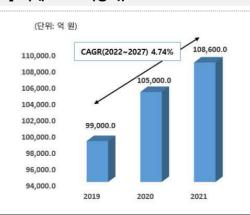
Precedence Research에 따르면, 세계 PCB시장 규모는 2021년 780억 달러에서 2030년 1,280억 달러로 성장할 것으로 예상되고 있으며, 한국PCB&반도체패키징산업협회(KPCA)에 따르면, 국내 PCB 시장 규모는 2021년 10조 8,600억 원 규모이다.

[그림 1] 세계 PCB 시장 규모



자료: Precedence Research, NICE디앤비 재구성

[그림 2] 국내 PCB 시장 규모



자료: 한국PCB&반도체패키징산업협회, NICE디앤비 재구성

■ 표면처리 산업

표면처리 산업은 전방산업의 발전과 경쟁력 유지를 위해 끊임없는 연구개발 및 기술 진보가 요구되는 기술 선도형 산업특징을 나타낸다. 자동차, 항공 전자제품 등 다양한 산업에서 내구성, 외관, 기능성 향상을 위해 금속 표면처리기술 수요가 증가하고 있으며, 환경보호 및 안전규제 강화로 친환경적인 대체기술을 개발하는 것이 주요 이슈로 작용하고 있다. 기술 고도화에 따른 고성능 제품 출시가 보편화됨에 따라, 신규 기술 수요에 대응하기 위한 참여업체의 기술 고도화가 요구되고 있으며, 기술력이 최종제품의 성능과 수명에 높은 영향을 미쳐 참여업체의 경쟁력으로 작용하므로 일관된 품질 유지와 공정 관리가 필수적이다.

표면처리 산업은 '뿌리산업 진흥과 첨단화에 관한 법률'에 의거 6대 뿌리산업으로 선정되어 지속적으로 지원받고 있다. 다양한 산업현장에서 품질경쟁력을 확보하기 위한 필수 요소로 자리매김함에 따라 산업 다양화·세분화·첨단화 트렌드에 맞춰 매우 다양한 표면처리 기술들이 개발되었다. 고객사에 따라 요구되는 금속 표면처리 방법 및 사양이 다르기 때문에 고객사의 주문을 받은 후 생산이 진행되는 주문형 수주 생산 산업 특징을보이며, 금속제품의 내구성, 기능성 및 외관을 개선하여 고부가가치 제품을 생산하는 산업으로 기본적인 원자재를 고품질의 최종제품으로 변환하여 경제적 가치를 향상시킬 수 있는 고부가가치 산업이다.

MarketsandMarkets(2023)에 따르면, 국내 금속 표면처리 시장규모는 2022년 기준 6조 1,786억 원이며, 이후 연평균 5.3% 증가하여 2027년 7조 9,792억 원에 이를 것으로 전망된다. 국내 금속 표면처리 분야는 첨단산업의 핵심 솔루션으로 주목받고 있으며, 단순 기능만을 요구했던 과거와는 달리 박형화·대형화되는 디스플레이 분야를 비롯하여 반도체 등 각종 첨단 분야에서의 활용도가 높아짐에 따라 시장 및 기술 선점을 위한 경쟁력 확보 방안이 요구되고 있다.

세계 금속 표면처리 시장규모는 2022년 기준 933억 달러이며, 이후 연평균 5.1% 증가하여 2027년 1,199억 달러에 이를 것으로 전망된다. 세계 시장은 자동차, 항공우주, 전자제품, 건설 등 다양한 산업에서 내구성, 부식 방지, 미적 품질 개선 등의 필요성으로 인해 꾸준히 성장하고 있으며, 최신 기술 발전과 친환경 표면처리 솔루션 도입으로 인해 성장하고 있다. 특히, 아시아 태평양 지역의 빠른 산업화와 도시화로 인해 주요 시장으로 부상하고 있다.

[그림 3] 국내 표면처리 시장규모 **CAGR 5.3%** (단위: 억 원) CAGR 8.5% 79,792 75,149 80,000 70,794 61,786 64,041 66,730 70,000 52,443 53,553 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2020 2022 2023(E) 2024(E) 2025(E) 2026(E) 2027(E) 2021

자료: MarketsandMarkets(2023), NICE디앤비 재구성



자료: MarketsandMarkets(2023), NICE디앤비 재구성

■ 경쟁사 분석

금속 표면처리 산업에 참여한 국내업체는 ㈜엠케이켐앤텍, ㈜아토텍코리아 등이 있다. 국내 참여업체는 환경 규제 대응을 위한 친환경 기술개발과 지속가능한 생산·운영이 중요한 이슈로 떠오르고 있으며, 주요 전방산업의 트렌드 변화 및 다양한 산업에서의 활용을 기반으로 새로운 시장 창출과 사업 다각화 기회를 맞이하고 있다.

㈜엠케이켐앤텍은 1996년 설립되어 전기전자부품 업계에 약품조달과 표면처리기술을 제공하며 성장하였다. 지속적인 연구개발로 표면처리용 약품의 국산화에 성공하고 무전해니켈, 전해금도금, 무전해동도금 등 다양한 표면처리약품을 제공하고 있으며, 특히 PCB 사업부에서는 PCB 회로도금 및 기판 최종 표면처리 기술을 전문적으로 제공하고 있다. 전문기업으로 구리 도금, 알루미늄 양극산화, 인산염피막, 니켈 무전해 도금 등의 공정기술을 적용하고 있다.

㈜아토텍코리아는 표면처리 장비 및 소재 공급업체로 전기도금 솔루션 분야에 특화되어 있다. PCB, 패키지 기판, 반도체, 리드프레임, 커넥터 제조용 도금 약품 및 장비를 개발, 생산하고 있다.

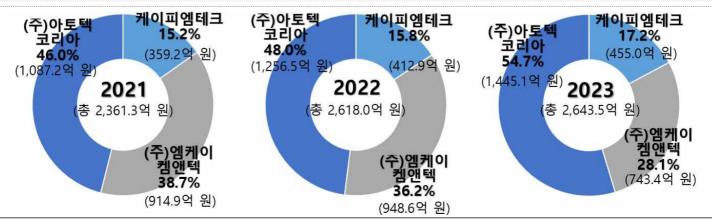
[표 4] 유사 비즈니스 모델 경쟁업체 현황

(단위: 억 원)

회사명	사업부문	매출액			기보저나 미 토지(2022.12 기즈)
최작경	시입구판	2021	2022	2023	기본정보 및 특징(2023.12. 기준)
케이피엠테크 (동사)	표면처리약품 및 장비	359.2	412.9	455.0	· 중소기업, 코스닥 상장(2003.01.07.) · 표면처리약품 및 자동화 도금 설비 제공 · K-IFRS 연결 기준
㈜엠케이켐앤텍	표면처리약품 및 장비	914.9	948.6	743.4	· 비상장 중소기업 · 표면처리약품 및 PCB 표면처리 전문 · K-IFRS 별도 기준
㈜아토텍코리아	표면처리약품 및 장비	1,087.2	1,256.5	1,445.1	· 비상장 중소기업 · 표면처리 장비 및 소재 전문기업 · K-IFRS 별도 기준

자료: 각 사 사업보고서(2023.12.), NICE디앤비 재구성

[그림 5] 경쟁업체와의 매출액 규모 비교 현황



자료: 각 사 사업보고서(2023.12.), NICE디앤비 재구성

Ⅲ. 기술분석

오랜 업력과 축적된 기술력으로 고객 주문 맞춤형 표면처리약품 및 장비 제공

동사는 고객사의 주문에 따라 PCB, 전자 통신 반도체, 자동차 부품용 표면처리약품과 도금처리 및 표면 처리를 기계적으로 처리해주는 장치를 개발 및 제조하고 있다.

■ 표면처리약품

표면처리는 금속 표면에 물리, 화학, 전기화학적 처리를 통해 금속 소재 및 부품 표면에 피막을 형성하여 내구성, 기능성, 심미성 등을 향상시킴으로써 소재 및 부품의 부가가치를 확보하는 기술을 말한다. 표면처리는 금속외에 세라믹, 폴리머 등에도 적용할 수 있지만 대부분 금속에 적용된다. 금속 표면처리는 피막을 형성시키는 원리 및 피막 소재의 종류에 따라 전기도금(음극공정), 양극산화, 무전해도금(화학도금), 용융도금, 금속침투, 금속용사, 증착, 표면경화, 도장, 코팅 등으로 구분할 수 있다.

동사는 PCB, 전자 통신 반도체, 자동차 부품용, 장식용 등 다양한 분야의 표면처리약품을 제공하며, 주요 제품으로는 PTC-CAT, PURICLE C-4, RS-370가 있다.

▶ PTC-CAT

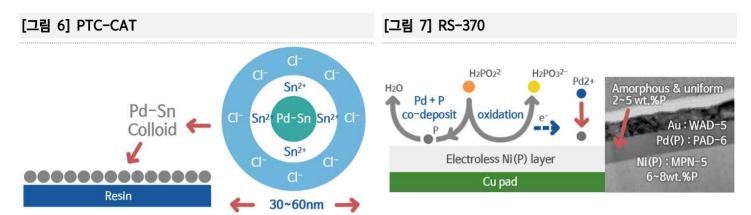
주석(Sn)과 팔라듐(Pd)으로 구성된 콜로이드 형태로, 고농도의 팔라듐(5g)이 포함되어 있다. 이 콜로이드는 도금 과정에서 균일한 분포를 제공하며, 도금층의 성능을 향상시킨다. PCT-CAT는 에칭 처리된 수지 표면에 촉매를 부여하여, 도금이 잘 부착되도록 한다. 이 과정은 표면의 활성화를 통해 도금의 접착력을 높이며, 최종 제품의 내구성을 향상시키는 데 기여한다. 액체 형태로 제공되어 보급 및 관리가 간편하며, 욕(도금 욕조)의 안 정성이 뛰어나 장기간 사용할 수 있고 도금 공정에서 일관된 성능을 유지할 수 있다. 균일한 흡착량을 제공하여 도금층이 고르게 형성될 수 있고, 고농축 형태로 제공되어 Drag Out(욕에서 제품이 흘러나가는 양)이 적어비용 절감 효과를 나타낼 수 있다. 도금 공정에서 효율성을 높이고 품질을 개선하며 경제적인 운영을 가능하게하는 중요한 촉매이다. 이러한 특성으로 다양한 산업분야에 널리 사용되고 있다.

▶ PURICLE C-4

PURICLE C-4는 주로 동(Cu) 및 동합금의 세정에 효과적인 탈지제이다. 동 및 동합금 표면의 기름, 오염물, 불순물을 효과적으로 제거하고, 금속 표면을 깨끗하게 유지하여 후속 공정의 품질을 높이는 데 기여한다. 침적 (immersion) 세척 방식과 전해(electrolytic) 세척 방식 모두에 적합하여 다양한 세정 공정에 유연하게 적용할수 있다. 특히 동(Cu) 및 동합금에 최적화되어 있어, 금속의 특성을 손상시키지 않으면서도 효과적으로 세정할수 있다.

▶ RS-370

RS-370은 전기 도금 및 전해 도금 공정에서 사용되는 물질로, 특히 KemiPal™ PAD-6라는 전기 도금 방식에서 팔라듐(Pd) 코팅의 균일한 형성을 지원한다. 자가 촉매 방식의 금(Au) 도금 욕조와 함께 사용되며 솔더접합에서 SPG-4를 통해 0.06 μm 두께의 도금을 10분 이내에 형성, 와이어 본딩에서 WAD-6을 사용하여 0.1 μm 두께의 도금을 10분 이내에 형성할 수 있다. RS-370은 전기 도금 공정 후 Rack 접점부의 도금층을 제거하는 데 사용되며, 후처리 과정에서 불필요한 도금층을 효과적으로 제거하여, 최종제품의 품질을 보장하는데 중요한 역할을 한다.



자료: 동사 홈페이지

자료: 동사 홈페이지

■ 표면처리 설비

표면처리 설비는 각종 도금처리 및 표면처리를 기계적으로 처리해 주는 장치로서 고객사의 주문 제작 방식으로 이루어지는 사업이다. 일반 도금 및 자동 도금과 표면처리 작업 등에 필요한 설비와 부품을 취급하며 주요 수요층은 PCB 및 전자부품 제조업체다.

동사는 전방산업인 PCB 사업, 전자부품 사업이 빠르게 고도화되고 정밀화되어감에 따라 도금처리 및 표면처리 장치들의 속도, 무게, 기능, 디자인 등을 지속해서 발전시켜 왔으며, 설비 자동화 및 무인화를 위한 연구개발을 지속하고 있다.

동사의 전자동 도금설비는 사용 용도에 따라 PCB, 반도체 Lead Frame, LCD 등의 표면을 처리하는 첨단산업 부품용 표면처리설비, 자동차의 그릴, 손잡이, 엠블럼 등의 표면을 처리하는 자동차용 부품 처리 설비, 화장품케이스, 장신구, 보석류 등의 표면을 처리하는 장신구류 부품 처리 설비 등 다양한 분야에 납품하고 있다. 최근에는 PCB용 도금설비와 반도체 Lead Frame, LCD 관련 도금설비들이 주목받고 있으며, 점차 많은 기술을 요구하는 첨단 IT 분야의 영역도 커지고 있다.

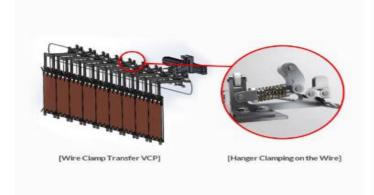
돗사의 주력 제품은 PCB 산업에 적용되는 수직 연속 이송 표면처리 설비이다.

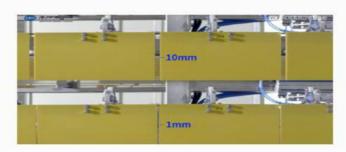
▶ 수직 연속 이송 표면처리 설비(Vertical Continuous Plating, VCP)

VCP 시스템은 수직으로 배열된 도금 탱크를 사용하여 공간을 효율적으로 사용하고 도금과정을 연속적으로 진행할 수 있게 한다. 와이어 또는 제품이 클램프에 의해 고정되어 수직으로 이동하면서 도금되며, 이 과정은 자동화되어 있어, 제품이 계속해서 도금 탱크를 통과하게 된다. 전해질 용액이 도금 탱크에 채워져 있으며, 전류가 흐르면서 금속 이온이 와이어 표면에 침착된다. 이 과정을 통해 균일한 도금층이 형성된다. 높은 생산성과 일관된 품질의 도금처리를 가능하게 한다.

특히, Wire Clamp Transfer(WCT) 시스템을 적용하여 제품 품질을 향상시키고 불량률을 감소시켰다. WCT 방식은 와이어에 클램프가 부착된 걸쇠를 이용, 클램프 걸쇠가 와이어에 고정이 되어 도금 구간에서 이송이 되기 때문에 도금 투입구에서 정확히 위치 결정된 기판 간격을 ± 1 mm 이내로 유지시켜줄 수 있다. 유산동 도금 구간에서 기판 간격을 1mm 이내로 지속해서 유지함으로써 도금 두께의 편차를 최소화할 수 있고, 이로 인해 CPK(공정 능력 지수)가 향상될 수 있다.

[그림 8] WCT 시스템을 적용한 VCP





자유로운기판 간격설정 가능 Setting 된기판 ±1 mm 이내 간격 유지

자료: 동사 홈페이지

■ 생산역량

동사는 베트남 법인을 설립하여 약품사업과 표면처리 기계설비 제작, 글로벌 영업 등을 수행하고 있다. 하노이에 업무 지원을 위한 사무소가 위치하고 있으며, 베트남 빈푹성에 약품사업장과 표면처리 임가공 사업장, 타이 응웬성에 기계설비 제작사업장과 비즈니스 호텔을 마련하고 있다.

약품사업장에서는 PCB전처리, PCB무전해금도금, 전장부품 및 통신부품 표면처리가공, 각종 신뢰성 분석 등의 업무를 수행하며 한국인 표면처리 전문인력과 다년간 훈련된 베트남인 가공, 검사인력이 업무를 수행하고 있다. 기계설비 제작사업장에서는 ENIG도금설비, ENEPIG도금설비, 전자동 Cu-Ag 도금설비, 바렐금속도금설비, Jet전처리설비, 후처리설비, 순수제조장치, 환경설비(폐수처리장치, 대기정화장치), 각종 분석장비를 구비하고 있으며, 보유 설비를 기반으로 각종 도금설비 제작, 부속장치의 제작, 환경설비의 제작, 설비의 유지보수가 이루어지고 있다.

[그림 9] 베트남 빈푹성 소재의 표면처리 임가공 사업장





자료: 동사 홈페이지

■ 연구개발 역량

동사는 기술연구소를 설립하고 다년간의 경험으로 축적된 노하우를 바탕으로 표면처리 약품 국산화를 위해 노력하고 있다. 기술연구소에서는 각종 표면처리 프로세스의 연구 및 개발, 각종 표면처리 약품의 연구 및 개발, 환경친화적 표면처리 약품 연구, 고객사와의 표면처리 기술 상담 및 고객사 맞춤 솔루션 제공, 표면처리 설비의 개발, 표면처리 설비 관련 제어 시스템 개발 등을 수행하고 있다. 기술연구소 운영을 통해 기술력 보강과 인적인프라 강화가 이루어지고 있으며, 영위하고 있는 사업과 관련하여 국내 특허권 7건, 상표권 4건, 디자인권 1건을 보유하여 지식재산권을 기반으로 한 진입장벽을 확보하고 있다.

[표 5] 동사의 연구개발비용

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021	2022	2023
연구개발비용	8.2	6.7	3.0
연구개발비 / 매출액 비율	2.45%	1.81%	0.86%

자료: 동사 사업보고서(2023.12.), NICE디앤비 재구성

[표 6] 동사의 주요 특허권 현황

발명의 명칭	등록일자	등록번호	적용 제품
다관절로봇용 인쇄회로기판 고정장치	2010.11.16	10-0995878	표면처리장비
단일조 방식의 세정장치	2011.12.22	10-1100372	표면처리장비
도금액 이동분사 구조를 갖는 기판도금장치	2012.04.12	10-1137776	표면처리장비
인쇄회로기판용 로드/언로드장치	2012.12.13	10-1214122	표면처리장비
폐수 구분배출구조를 갖는 세정장치	2013.05.14	10-1266095	표면처리장비
무전해니켈 도금액 및 이를 이용한 전자부품	2014.11.11	10-1462562	표면처리장비
수직형 연속 도금 설비를 위한 기판이송설비	2021.04.29	10-2248854	표면처리장비

자료: 특허정보검색서비스(KIPRIS), NICE디앤비 재구성

IV. 재무분석

수익성은 적자 지속 중이나, 최근 3개년 매출 성장하였고, 자본금 증자로 안정성은 양호함

동사는 표면처리 및 도금처리 약품 사업과 관련 기계 장치 사업을 병행하고 있는 가운데, 매출액은 3년 간 증가세를 나타내었고, 수익성은 적자 기조 지속하고 있으나, 부채 부담이 낮은 재무구조 양호한 편임

■ 최근 3개년 양호한 외형 성장세 유지

동사는 표면처리 관련 약품을 상품 및 제품의 형태로 유통하거나 제조하고 있으며, 도금처리 및 표면처리를 기계적으로 처리하는 작업에 필요한 설비 및 부품을 제조하고 있다. 주로 주문 제조 판매 형식으로 제품을 공급하고 있으며, 해외 수출을 병행하고 있는 가운데, 2023년 기준 연간 수출 비중은 30% 가량을 나타내었다.

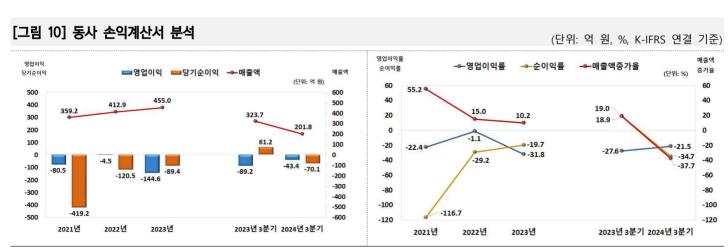
2021년 연결 기준 전년 대비 55.2% 증가한 359.2억 원의 매출액을 기록한 이후, 2022년 내수 상품(PCB약품, 기능성 도금약품 등)의 매출실적 호조로 전년 대비 15.0% 증가한 412.9억 원의 매출액을 기록하였다. 2023년은 진공증착장비 매출이 신규로 발생하며 전년 대비 10.2% 증가한 455.0억 원의 매출액을 기록, 최근 3개년 간 매출 외형 증가세를 나타내었다.

다만, 2024년 3분기 누적 약품사업부문 실적과 기계 제품 실적 모두 감소해 전년 동기 대비 37.7% 감소한 201.8억 원의 매출액을 기록하였다.

■ 과중한 매출원가 및 영업외비용(금융원가, 지분법손실 외)으로 인해 적자기조 지속

최근 3개년간 과중한 매출원가 부담으로 인하여 적자를 지속했으며, 영업손실로 2021년 80.5억 원, 2022년 4.5억 원, 2023년 144.6억 원을 기록하였다. 금융원가 및 지분법손실(㈜한일진공 등) 등 영업외수지 적자로 인해 2021년 419.2억 원, 2022년 120.5억 원의 대규모 당기순손실을 기록하였고, 2023년은 관계기업투자주식처분이익(㈜에스비티엘첨단소재 지분율 감소로 처분이익 인식) 등에 따른 영업외수지 흑자에도 불구하고 당기순손실 89.4억 원을 기록하며 취약한 수익성이 지속되었다.

한편, 2024년 3분기 누적 기준 매출 부진, 과중한 매출원가 부담 등으로 인하여 영업손실 43.4억 원, 당기순손실 70.1억 원을 기록하며 적자기조를 지속하였다.



자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.09.), NICE디앤비 재구성

■ 순손실 지속에도 불구하고 유상증자 등 자본 확충으로 양호한 재무구조 유지

최근 3개년간 적자를 지속했으나 유상증자 및 전환청구 등으로 인하여 자기자본이 확충됨에 따라 동사의 부채비율은 2021년 40.2%, 2022년 32.2%, 2023년에는 39.1%를 기록하는 등 30~40%대 수준을 지속하였고, 2024년 3분기에도 40.7%의 부채비율을 기록하는 등 전반적인 부채 부담은 낮은 수준을 유지하고 있다.

또한, 유동비율은 각각 2021년 73.7%, 2022년 130.3%, 2023년 82.9%를 기록하며 등락을 나타내었고, 최근 2024년 3분기 유동비율은 102.9%로서 100%대를 회복하며 무난한 수준을 나타낸 바, 최근 3개년 재무제표고려 시 유동성은 다소 제한적이나, 전반적인 재무구조는 양호한 편으로 판단된다.



자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.09.), NICE디앤비 재구성

[표 7] 동사 요약 재무제표

(단위: 억 원, K-IFRS 연결 기준)

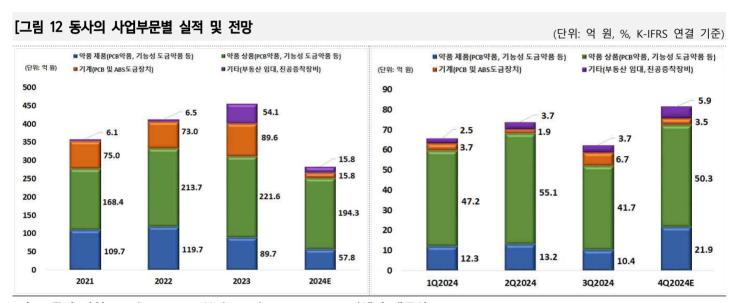
항목	2021년	2022년	2023년	2023년 3분기 누적	2024년 3분기 누적
매출액	359.2	412.9	455.0	323.7	201.8
매출액증가율(%)	55.2	15.0	10.2	19.0	-37.7
영업이익	-80.5	-4.5	-144.6	-89.2	-43.4
영업이익률(%)	-22.4	-1.1	-31.8	-27.6	-21.5
순이익	-419.2	-120.5	-89.4	61.2	-70.1
순이익률(%)	-116.7	-29.2	-19.7	18.9	-34.7
부채총계	377.3	313.3	490.6	350.4	407.1
자본총계	938.2	973.5	1,253.9	1,341.0	999.4
총자산	1,315.5	1,286.8	1,744.5	1,691.4	1,406.5
유동비율(%)	73.7	130.3	82.9	176.5	102.9
부채비율(%)	40.2	32.2	39.1	26.1	40.7
자기자본비율(%)	71.3	75.7	71.9	79.3	71.1
영업현금흐름	2.1	-28.1	-117.0	-82.1	-124.3
투자현금흐름	91.6	47.0	-75.4	182.2	-29.3
재무현금흐름	-6.2	77.5	23.9	-51.0	163.2
기말 현금	98.6	194.2	74.1	292.2	57.5

자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.09.)

■ 동사 실적 전망

동사는 2021년 359.2억 원의 매출액을 기록한 이후, 2022년 PCB약품, 기능성 도금약품 등의 매출실적 호조로 전년 대비 증가한 412.9억 원의 매출액을 기록하였다. 2023년은 진공증착장비 매출이 신규로 발생하며 455.0억 원의 매출액을 기록, 최근 3개년 간 매출 외형 증가세를 나타내었다.

그러나, 2024년 3분기 누적 약품사업부문 실적과 기계 제품 실적 모두 감소해 전년 동기 대비 37.7% 감소한 201.8억 원의 매출액을 기록하였고, 2024년 4분기도 유사한 추이를 보일 것으로 예상되는 바, 2024년 매출은 하락할 것으로 전망된다.



자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.09.), NICE디앤비 재구성

[표 8] 동사의 사업부문별 연간 실적 및 분기별 전망

(단위: 억 원, %, K-IFRS 연결 기준)

항목	2021	2022	2023	2024E	1Q2024	2Q2024	3Q2024	4Q2024E
매출액	359.2	412.9	455.0	283.7	65.7	73.9	62.5	81.6
약품 제품(PCB약품, 기능성 도금약품 등)	109.7	119.7	89.7	57.8	12.3	13.2	10.4	21.9
약품 상품(PCB약품, 기능성 도금약품 등)	168.4	213.7	221.6	194.3	47.2	55.1	41.7	50.3
기계(PCB 및 ABS도금장치)	75.0	73.0	89.6	15.8	3.7	1.9	6.7	3.5
기타(부동산 임대, 진공증착장비)	6.1	6.5	54.1	15.8	2.5	3.7	3.7	5.9

자료: 동사 사업보고서(2023.12.), 분기보고서(2024.09.), NICE디앤비 재구성

V. 주요 변동사항 및 향후 전망

종속회사 및 바이오 사업분야 변동사항

동사는 종속회사인 ㈜뉴온, ㈜하나켐텍을 연결대상에서 제외하였고, 제약 바이오 사업부문의 렌질루맙계약을 해지하였다.

■ ㈜뉴온, ㈜하나켐텍 연결대상에서 제외

동사의 자회사인 진공증착장비 업체 (주)한일진공이 계속기업으로서의 불확실성을 없애기 위해 건강기능식품 업체 ㈜뉴온을 흡수합병하였고, 상호명을 ㈜뉴온으로 변경하였다. 합병에 따른 실질지배력 감소로 인해 종속기업에서 관계기업으로 변경하여 연결회사에서 제외되었다. 도금 업체인 ㈜하나켐텍은 2023년 12월 청산이 종결되어 2024년부터 연결회사에서 제외되었다.

■ 렌질루맙(Lenzilumab, COVID-19 치료제)의 한국 및 필리핀 라이선스 계약 해지

동사는 ㈜휴머니젠과 렌질루맙(Lenzilumab, COVID-19 치료제)의 한국 및 필리핀 라이선스 도입 계약을 체결하고 렌질루맙의 임상, 출시, 상업화를 진행하였으나, 미국 임상 3상 완료 및 긴급사용승인 신청이 데이터 부족으로 거절되었다. 이에 따라 2024년 1월 ㈜휴머니젠이 파산절차를 진행하였으며, 자본잠식 해소와 채무변제 재원을 마련하기 위해 자산을 매각하는 변제계획을 수립하고, 우선협상대상자인 타란 테라퓨틱스(Taran Therapeutics Inc.)와 자산매입계약을 체결하였다. 동사는 파산절차를 진행한 ㈜휴머니젠에 계약해지 내용을 통지하고 렌질루맙에 대한 계약을 해지하였다.

	증권사	투자의견	
작성기관	투자의견	목표주가	작성일

투자의견 없음



자료: 네이버증권(2024.11.19.)

최근 6개월간 한국거래소 시장경보제도 지정여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다.

시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

기업명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
케이피엠테크	X	X	X
	,	,	